

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MASSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

15/00

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1995AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
0	NEUE ZEICHNUNG	29.11.95	M.STEIN
A	BLATT 2 VON 2 NEU HINZU	18.03.96	M.STEIN
B	PN 966 851-2 NEU HINZU	26.06.96	M.STEIN
B1	NEW PCB LAYOUT	05.02.97	B. RITHENER
C	NEW -3, -4	19.06.97	S. KEMPTER
D	ADAPTATION TO PACKAGING NORM	14.04.00	B. RITHENER
E	REV PER 0S14-0487-02	02.05.03	K. WEIDNER
E1	REV PER ECO 07-011908	10.10.07	J.LIPPERT

NUMMER 966 851

VERWENDET FÜR -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

DIM "A"

1.74: PCB MIT MASSE VERBINDUNG AUF DER UNTERSEITE
2.07: PCB OHNE MASSE AUF DER UNTERSEITE
1.74: PCB WITH VIA CONNECTION AND GROUND ON THE OTHER SIDE
2.07: PCB WITHOUT GROUND ON THE OTHER SIDE

7 KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22220
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22220

8 VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING

11 VERGOLDET NACH AMP SPEZ. 112-162-5; 0.8µm
MIN. DICKE ÜBER VERNICKELUNG NACH AMP SPEZ.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. DICKE.
GOLD-PL. PER AMP SPEC. 112-162-5; 0.8µm
MIN. THK. OVER Ni-PL. PER AMP SPEC.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.

9 SMD-GURTVERPACKUNG NACH IEC 60286-3
SMD-STRIP-PACKAGING ACCORDING TO IEC 60286-3

10 EIN KUPPLER IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
ONE JACK PACKED IN PLATIC BAG

RECOMMENDED PCB: MATERIAL: FR4
THICKNESS 1.6 mm
DIELECTRIC CONSTANT = 4.8
PLATING: 30µm-70µm Cu

1	1	1	1	4	KUPPLERKÖRPER SHELL	CuZn	8
1	1	1	-	3	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	11
1	1	1	1	2	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	8
1	1	1	1	1	ISOLIERSTÜTZE DIELECTRIC	PTFE	
966851-4	966851-3	966851-2	966851-1	ITEM NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING
				GEZ.	29.11.95	GEPR.	29.11.95
					M. STEIN		D. BOZZER

AMP		DSM AN AMP COMPANY St MAURICE, SWITZERLAND	
BENENNUNG/DESCRIPTION			
COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTENMONTAGE (RASTER 5,08 mm)			
COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5,08 mm)			
NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	
± 0.5 ± -	A3	966851	
MASSTAB/SCALE	BLATT/SHEET	REV.	
10:1	1 VON 2	E1	

WAR NR. E89-52650-342

PASSEND ZU -

C

A

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

966851

NUMMER

VERWENDET FÜR

PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERNLOK
FK
DIST

WAR NR.

M3:1

Top view of the SMD coupler assembly. Dimensions include a total width of 16, a distance of 1.75 from the left edge to the first hole, a hole diameter of 1.5, a distance of 12 between the first and second holes, and a distance of 4 between the second and third holes. The distance between the first and second couplers is 6.2±0.13. A section line A-A is shown on the left, and a section line B-B is shown at the bottom. A callout 5 points to the coupler area.

SCHNITT A-B
SECTION A-B M3:1

Cross-section A-B of the SMD coupler assembly. Dimensions include a total height of 6.31±0.13 and a thickness of 0.4. The assembly consists of an SMD coupler (SMD-KUPPLER) and an SMD jack (SMD-JACK) mounted on a substrate.

Blister belt layout showing dimensions and callouts. The overall length is 330±0.5. The distance between the center of the first and second couplers is 16.4^{+0.2}₀. The distance between the center of the first and second couplers is 13±0.5. The distance between the center of the first and second couplers is 160. A callout 1 points to the last runnings, callout 2 points to the blister belt filled with parts, callout 3 points to the empty blister belt, and callout 4 points to the polystyrene material. A dimension of 400 is shown for the length of the last runnings.

6 EINHEIT PRO REEL: 800 STK.
UNIT PER REEL: 800 PIECES5 BLISTERGURT NACH IEC 60286-3
BLISTER BELT ACCORDING TO IEC 60286-34 AUS POLYSTYREN
MADE FROM POLYSTYRENE3 VORLAUF: MIN.400mm TRÄGERGURT NACH
IEC 60286-3
(LEER, ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
OFFSET: MIN.400mm BLISTER BELT ACCORDING TO
IEC 60286-3 (EMPTY, BUT SEALED WITH
COVERBELT)2 BLISTERGURT BESTÜCKT MIT BAUTEILEN
BLISTER BELT FILLED WITH PARTS1 NACHLAUF NACH IEC 60286-3
(LEER ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
LAST RUNNINGS ACCORDING TO IEC 60286-3
(EMPTY, BUT SEALED WITH COVERBELT)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 15/00

AMP

DSM AN AMP COMPANY
ST MAURICE, SWITZERLANDBENENNUNG
COAXICON® SERIE MCX, SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTEN-
MONTAGE (RASTER 5.08 mm)
COAXICON® SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB
(PITCH 5.08 mm)

C

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,5 ± -	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 966851
			GEZ. M. STEIN 29.11.95	GEPR. D.Bozzer 29.11.95				
MASSTAB -						BLATT 2 VON 2	REV. E1	

AMP-EN-555 REV 9-93